

Claims

1. (A) 環状アセタール化合物、(B) エポキシ化合物、及び(C) 光カチオン性重合開始剤を含有してなる光硬化性樹脂組成物。
2. (A) 環状アセタール化合物5～80重量%、(B) エポキシ化合物94.9～20重量%、及び(C) 光カチオン性重合開始剤0.1～10重量%((A)成分と(B)成分と(C)成分の合計は100重量%である。)を含有してなる光硬化性樹脂組成物。
3. (A) 環状アセタール化合物10～40重量%、(B) エポキシ化合物89.8～60重量%、及び(C) 光カチオン性重合開始剤0.2～6重量%((A)成分と(B)成分と(C)成分の合計は100重量%である。)を含有してなる光硬化性樹脂組成物。
4. (A) 環状アセタール化合物が、トリオキサン、1,3-ジオキソラン、1,3-ジオキサン、1,4-ブタンジオールホルマールおよびジエチレングリコールホルマールから選ばれる1種以上である請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。
5. (B) エポキシ化合物が、(i) エポキシシクロヘキシル基含有化合物及び/又は(ii) グリシジル基含有化合物である請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。
6. (B) エポキシ化合物が、さらに、(iii) GPCで測定したポリスチレン換算の数平均分子量が1,000～20,000であるエポキシ高分子化合物を含む請求項5に記載の光硬化性樹脂組成物。
7. (C) 光カチオン性重合開始剤が、芳香族オニウム塩である請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。
8. 芳香族オニウム塩が、トリアリールスルホニウム塩である請求項7に記載の光硬化性樹脂組成物。

9. (A) 成分、(B) 成分及び(C) 成分のほかに、さらに1分子中に2個以上の水酸基を有するポリオール(d)を含む請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。

10. ポリオール(d)が、1分子中に2～6個の水酸基を有するポリオールである請求項9に記載の光硬化性樹脂組成物。

11. (A) 成分、(B) 成分及び(C) 成分のほかに、さらにエチレン性不飽和モノマー(e)および光ラジカル重合開始剤(f)を含む請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。

12. (A) 成分、(B) 成分及び(C) 成分のほかに、さらに光増感剤(g)を含む請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。

13. 粘度(25°C)が50～2,000mPa・sである請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物。

14. 請求項1～3のいずれか1項に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。

15. 請求項4に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。

16. 請求項5に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。

17. 請求項6に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。

18. 請求項7に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。

19. 請求項8に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。

20. 請求項9に記載の光硬化性樹脂組成物を光硬化してなる硬化物。